# 3D 打印耗材称项目计划书 项目计划书

小组成员: 马邢龙 陈桢杰 曹正阳

## 3D **打印耗材称项目计划书**

一、项目简介	1
二、项目基本方案	2
1. 设计原则	2
2. 设计方案	
3. 功能目标	2
三、项目工程目标	3
1. 量化目标	3
2. 测量关键指标	3
3. 适配性目标	3
四、项目实施计划和任务分配	4
1. 团队分工	4
2. 实施计划	4 4
五、采购清单	5
1. 硬件采购清单	5
2. 费用总计	5
3. 用途说明	5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6

## 一、项目简介

本项目以 3D 打印耗材称为对象,目标是探索一种测量耗材重量的有效方案,并在 实践中学习测量系统的设计与实现。限于时间和方案预算,项目的重点不在于最终产品 的实用性,而在于通过以下方面积累相关知识:

- (1) 理解测量系统的核心组成部分,包括压力传感器、数据采集模块和处理单元;
- (2) 练习嵌入式系统设计与硬件接口开发的基础知识;
- (3) 探索传感器数据的采集与误差分析方法;
- (4) 学习如何通过实验验证测量系统的精度和稳定性。

## 二、项目基本方案

### 1. 设计原则

- 非破坏性改装: 在不改变打印机结构的前提下进行改装;
- 高精度测量: 测量精度控制在 ±1 克以内;
- 兼容性: 完全适配耗材轴, 保证耗材正常转动;
- 易安装与维护: 用户可快速安装与拆卸。

## 2. 设计方案

#### 2.1 硬件设计

- 称重平台: 托架安装压力传感器, 固定耗材轴;
- 传感器组件: 采用 2KG 压力传感器和 HX711 ADC 模块;
- 控制与显示: ESP32-C3 负责数据采集与处理, 数码管实时显示测量结果。

#### 2.2 非破坏性改装

通过设计可拆卸托架和滚动支架,确保耗材轴在称重装置上的正常旋转。

## 3. 功能目标

- 实时重量测量: 精确测量耗材重量;
- 兼容耗材轴: 保证称重装置与耗材轴完全匹配;
- 长时间稳定性: 在长时间打印过程中保持测量数据稳定。

## 三、项目工程目标

### 1. 量化目标

#### (1) 精度:

- 静态误差: 测量误差控制在 ±1 克以内;
- 动态误差: 耗材轴旋转时, 测量误差控制在 ±2 克以内;
- 重复性误差: 多次称重的标准偏差不超过 0.5 克。
- (2) 成本: 总成本不超过 500 元;
- (3) 开发时间:项目周期控制在3周内,乐观估计工作量在10人天左右。

### 2. 测量关键指标

#### • 动态测量:

- 系统响应时间: 采样频率不少于 10 Hz, 以满足实时监测需求;
- 数据更新速率:显示或输出的重量数据需保持每秒至少更新一次;
- 动态线性度误差: 在动态条件下, 系统测量结果的线性误差应不超过 0.2% FS。

#### 静态测量:

- 静态稳定性: 在恒定负载下, 重量测量的波动范围应不超过 ±0.5 克;
- 最小分辨率: 能够分辨至少 0.1 克的重量变化;
- 长期稳定性: 在长时间工作(>10 小时)后,测量误差漂移应小于 0.5% FS。

#### • 环境适应性:

- 温度漂移: 工作温度范围为 0 50°C, 温度漂移应不超过 0.05% FS/°C;
- 抗振动性能:系统在轻微振动(例如打印机运行产生的振动)下需保持测量精度。

## 3. 适配性目标

- 完全适配 Bambu A1 型打印机的耗材轴;
- 保证称重装置在运行过程中不影响打印操作。

## 四、项目实施计划和任务分配

### 1. 团队分工

- 马邢龙:
  - 参与初步方案设计。
- 曹正阳:
  - 方案设计的进一步细化;
  - 3D 建模与设计;
  - PCB 硬件制造;
  - 支持嵌入式开发。
- 陈桢杰:
  - 嵌入式开发,包括数据采集、处理和显示功能的实现。

### 2. 实施计划

项目计划在 3 周内完成, 团队成员任务并行进行:

### 2.1 第 13 周: 需求分析与细化设计

• 曹正阳: 细化方案设计, 完成硬件选型和初步 3D 建模。

• **陈桢杰**: 搭建嵌入式开发环境, 初步学习 ADC 和数码管模块使用。

### 2.2 第 14 周: 硬件建模与软件开发

• 曹正阳: 完成 3D 建模和称重平台设计,制作并测试 PCB 硬件。

• 陈桢杰: 编写传感器数据采集和显示程序。

## 2.3 第 15 周:系统集成与测试优化

• 曹正阳: 协助嵌入式调试, 优化硬件设计。

• 陈桢杰: 完成系统集成测试, 优化嵌入式算法。

## 五、采购清单

## 1. 硬件采购清单

序号	商品名称	型号规格	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	ESP32-C3 开发板	ESP32-C3 经典款-未焊接排针	6	12.5	75
2	压力传感器	2KG	2	132.41	264.82
3	ADC 模块	HX711 模块/标准版	3	2.1	6.3
4	数码管	0.56 英寸 4 位共阳红色	3	1.3	3.9

表 1 硬件采购清单

## 2. 费用总计

• 硬件总费用: 350.02 元

## 3. 用途说明

• ESP32-C3 开发板: 作为核心微控制器, 用于数据采集和通信。

• 压力传感器: 测量耗材重量的主要部件, 2KG 量程适合耗材的精确称重。

• HX711 ADC 模块:用于将传感器的模拟信号转换为数字信号,供 ESP32 处理。

• 数码管: 用于显示重量数据, 便于直观读取。

## 六、项目预算

本项目总预算为500元,具体分配如下:

- **硬件部分**:包括核心微控制器、压力传感器、ADC 模块、数码管等组件,总计 **350.02** 元。
- 预留预算:用于额外硬件采购或组件替换,约 149.98 元。